

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成22年5月13日(2010.5.13)

【公開番号】特開2007-321177(P2007-321177A)

【公開日】平成19年12月13日(2007.12.13)

【年通号数】公開・登録公報2007-048

【出願番号】特願2006-150084(P2006-150084)

【国際特許分類】

C 25 D 7/00 (2006.01)

C 25 D 5/12 (2006.01)

C 25 D 5/50 (2006.01)

H 01 L 23/50 (2006.01)

H 01 R 13/03 (2006.01)

C 22 C 13/00 (2006.01)

【F I】

C 25 D 7/00 H

C 25 D 5/12

C 25 D 5/50

H 01 L 23/50 D

H 01 R 13/03 D

C 22 C 13/00

【手続補正書】

【提出日】平成22年3月25日(2010.3.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

被覆層が素材側からNiまたはNi合金下地めっき層、Cu-Sn合金中間めっき層、表層のSnめっき層からなり、155で16時間加熱した際にCu-Sn合金中間めっき層厚さが加熱前のCu-Sn合金中間めっき層厚さの1~1.3倍であることを特徴とする耐ウェスカーキ性に優れ、はんだ付け性が良好な銅合金リフロー-Snめっき材。

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項2】

被覆層が素材側からNiまたはNi合金下地めっき層、0.3μm以下のCu中間めっき層、Cu-Sn合金中間めっき層、表層のSnめっき層からなり、155で16時間加熱した際にCu-Sn合金中間めっき層厚さが加熱前のCu-Sn合金中間めっき層厚さの1~1.3倍であることを特徴とする耐ウェスカーキ性に優れ、はんだ付け性が良好な銅合金リフロー-Snめっき材。